



Traduction

Certificat d'examen CE de type

— Directive 94/9/CE —

**Appareils et systèmes de protection
destinés à être utilisés en atmosphères explosibles**

BVS 05 ATEX E 111 U

- (4) **Appareil :** Platine processeur de Type 800
- (5) **Fabricant :** Micro Motion, Inc.
- (6) **Adresse :** Boulder, Co. 80301, ETATS-UNIS
- (7) Le type de ce composant, ainsi que ses différentes variantes autorisées, sont indiqués dans l'Annexe au présent certificat d'examen.
- (8) L'organisme de certification d'EXAM BBG Prüf- und Zertifizier GmbH, organisme notifié sous le n° 0158 conformément à l'article 9 de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994, atteste que le composant satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé en matière de conception et de construction d'appareils et de systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles conformément à l'Annexe II de la directive.
Les résultats des essais sont consignés dans le Procès-verbal d'essai BVS PP 05.2075 EG.
- (9) Les exigences essentielles de sécurité et de santé sont remplies du fait de la conformité à :
- EN 50014:1997 + A1 – A2 Dispositions générales
EN 50020:2002 Sécurité intrinsèque 'i'
- (10) Le signe "U" qui se trouve derrière le numéro du certificat indique que le présent Certificat ne doit pas être confondu avec un certificat prévu pour un appareil ou un système de protection. Le présent Certificat ne doit servir que de base à la certification d'un appareil ou d'un système de protection.
- (11) Le présent Certificat d'examen CE de type ne porte que sur la conception et les essais du type du composant décrit conformément à la directive 94/9/CE.
La fabrication et la mise sur le marché du composant sont soumises à d'autres exigences stipulées par la directive, lesquelles ne sont pas couvertes par le présent Certificat.
- (12) L'identification de ce composant doit comprendre les indications suivantes :



II 2G EEx ib IIB/IIC T5

EXAM BBG Prüf- und Zertifizier GmbH
Bochum, le 21 juillet 2005

Signature
Organisme de certification

Signature
Service spécialisé

(13) **Annexe au**

(14) **Certificat d'examen CE de type**

BVS 05 ATEX E 111 U

(15) 15.1 Objet et type
 Platine processeur de Type 800

15.2 Description

La Platine processeur sert au raccordement des capteurs au transmetteur.

Les composants électriques sont entièrement scellés dans un boîtier en plastique. Sur ce boîtier sont placées des bornes pour le raccordement des circuits électriques à partir du et vers le transmetteur, le raccordement du capteur se faisant au moyen d'un câble à raccord fixe avec un connecteur à 9 fiches.

15.3 Paramètres

15.3.1 Circuits d'alimentation (borniers J1-1, J1-2, J2-1 et J2-2)

Tension	Ui	DC	17,3	V
Intensité	Ii		484	mA
Puissance	Pi		2,1	W
Capacité interne effective	Ci		2200	pF
Inductance interne effective	Li		30	μH

15.3.2 Circuits de sortie (du capteur)

15.3.2.1 Circuit d'excitation (ergots J4 7 - 8)

Tension	Uo	DC	10,5	V
Intensité	Io		2,45	A
Puissance	Po		2,54	W
Résistance interne	Ri		4,32	Ω

Pour le groupe IIC

Capacité externe max.	Co		2,41	μF
Inductance externe max.	Lo		5,9	μH
Rapport max. inductance ext./résistance ext.	Lo/Ro		5,5	μH/Ω

Pour le groupe IIB

Capacité externe max.	Co		16,8	μF
Inductance externe max.	Lo		24	μH
Rapport max. inductance ext./résistance ext.	Lo/Ro		22	μH/Ω

15.3.2.2 Circuit de détection (ergots J4 3 - 6)

Tension	Uo	DC	17,3	V
Intensité	Io		18,05	mA
Puissance	Po		30	mW

Pour le groupe IIC
 Capacité externe max. Co 353 nF
 Inductance externe max. Lo 109 mH
 Rapport max. inductance ext./résistance ext. Lo/Ro 1,19mH/Ω

Pour le groupe IIB
 Capacité externe max. Co 2,06 μF
 Inductance externe max. Lo 436 mH
 Rapport max. inductance ext./résistance ext. Lo/Ro 4,75mH/Ω

15.3.2.3 Circuit de la sonde de température (ergots J4 1,2 et 9)

Tension Uo DC 17,3 V
 Intensité Io 4,61 mA
 Puissance Po 20 mW

Pour le groupe IIC
 Capacité externe max. Co 353 nF
 Inductance externe max. Lo 1,67 H
 Rapport max. inductance ext./résistance ext. Lo/Ro 1,78mH/Ω

Pour le groupe IIB
 Capacité externe max. Co 2,06 μF
 Inductance externe max. Lo 6,69 H
 Rapport max. inductance ext./résistance ext. Lo/Ro 7,14mH/Ω

15.3.3 Plage de température ambiante Ta - 40 °C à + 60 °C

(16) Procès-verbal d'essai
 BVS PP 05.2075 EG, en date du 21.07.2005

(17) Consignes d'utilisation

17.1 La Platine processeur doit être encadrée dans un boîtier qui assure au moins une protection de niveau IP 20, conformément à la norme EN 60529.

17.2 L'encastrement de la Platine processeur dans un boîtier doit être réalisé de telle sorte que l'entrefer entre les éléments de raccordement et les parties métalliques mises à la terre soit au minimum de 3 mm.

Exam – Postfach 10 27 48 – 44727 Bochum

Micro Motion Inc.
7070 Winchester Circle
Boulder, Co.
Etats-Unis

Carl-Beyling-Haus
Dinnendahlstrasse 9
44809 Bochum

Telefon 0234 – 3696-105
Telefax 0234 – 3696-110

Traduction

V/Réf. H. van Holland
V/courrier 14.09.2005
N/Réf. A 20050542 BVS-Schu/Mi
Tél. +49 234 36 96 105
E-mail Schumann@bg-exam.de

Le 10.10.2005

Mesdames, Messieurs,

Nous avons intégré le rapport de modification du 10.10.2005 au procès-verbal d'essai BVS PP 05.2075 EG.

Par la présente, nous confirmons que le certificat

BVS 05 ATEX E 111 U dans sa version du 21.07.2005

est encore valable.

Recevez nos sincères salutations.
BBG Prüf- und Zertifizier GmbH

Signatures

P. J. : Rapport de modification
Documents d'essai
Facture

EXAM
BBG Prüf- und Zertifizier
GmbH

Geschäftsführung:
Dr.-Ing. Reinhard Bassier
Dr.-Ing. Günter Levin

Sitz: Bochum
Amtsgericht Bochum
HRB 5357

Bankverbindung:
Commerzbank Bochum
BLZ 430 400 36
Konto 20 50 250

e-mail: info@bg-exam.de
<http://www.bg-exam.de>

Cette traduction ne peut être reproduite que dans son intégralité. Traduit de l'Allemand en Français par : Translation Services, BP 203, 8860 AE Harlingen, Pays-Bas, translations@wxs.nl. Harlingen, 17.10.2005.

Traduction



1^{er} Supplément

(Supplément conformément à la Directive 94/9/CE Annexe III alinéa 6)

au Certificat d'examen CE de type BVS 05 ATEX E 111 U

Appareil : Platine processeur de Type 800
Fabricant : Micro Motion, Inc.
Adresse : Boulder, Co. 80301, ETATS-UNIS

Description

La platine processeur peut également être fabriquée conformément aux documents descriptifs listés dans le Procès-verbal d'essai mentionné ci-dessous. Par ailleurs, pour les tests de la platine, la série de normes EN 60079-* a été utilisée ; il en résulte une identification modifiée en matière de normes.

Les exigences essentielles de sécurité et de santé sont remplies par le modèle modifié du fait de sa conformité à :

EN 60079-0:2006 Exigences générales
EN 60079-11:2007 Sécurité intrinsèque 'i'

L'identification de l'appareil doit comporter les indications suivantes :



II 2G Ex ib IIB/IIC T5

Conditions particulières en vue de l'utilisation en toute sécurité, ou consignes d'utilisation
Inchangées.

Procès-verbal d'essai

BVS PP 05.2075 EG, version du 03.08.2007

DEKRA EXAM GmbH

Bochum, le 3 août 2007

Signature

Signature

Organisme de certification

Service spécialisé

Page 1 de 1 de BVS 05 ATEX E 111 U / N1

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans modification.

DEKRA EXAM GmbH – Dinnendahlstrasse 9 – D-44809 Bochum – Tél. : +49 234 36 96 105, Fax : +49 234 36 96 110 – e-mail : zs-exam@dekra.com
(jusqu'au 31.05.2003 : Deutsche Montan Technologie GmbH – Am Technologiepark 1 – D-45307 Essen)